CP-5000D
～電子部品電極用銅ペースト～

電子部品の電極部分に適用可能な樹脂硬化型銅ペーストです。

特徴

●銀から銅への変更によりコストダウンが可能です。
●銅ベーストと同等の性能を有します。
●樹脂を含有しているため基板実装後にかかる応力を緩和します。

電子部品への適用箇所

●電子部品の樹脂電極層、下地電極層に銅ベーストを適用できます。

硬化プロファイル

●大気硬化、窒素硬化に対応しており、銅ベースト膜上にめっき形成が可能です。

硬化膜の抵抗変化

●良好な信頼性を有します。

高温高湿放置評価（85℃/85％RH）